

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年1月13日(2005.1.13)

【公表番号】特表2001-506057(P2001-506057A)

【公表日】平成13年5月8日(2001.5.8)

【出願番号】特願平10-525540

【国際特許分類第7版】

H 01 L 23/12

H 01 L 21/60

【F I】

H 01 L 23/12 L

H 01 L 21/60 3 1 1 W

【手続補正書】

【提出日】平成16年4月2日(2004.4.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 手続補正書

平成16年 4月 2日



特許庁長官殿

## 1. 事件の表示

平成10年特許願第525540号

## 2. 補正をする者

氏名（名称） ミネソタ・マイニング・アンド・  
マニュファクチャリング・カンパニー

## 3. 代理人

住所 〒540-0001  
大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル  
青山特許事務所  
電話 06-6949-1261 FAX 06-6949-0361

氏名 弁理士 (6214) 青山 葵



## 4. 補正対象書類名 請求の範囲

## 5. 補正対象項目名 請求の範囲

6. 補正の内容  
別紙の通り

## 請 求 の 範 囲

1. 集積回路用パッケージであつて、

電気的接続部のアレイを含む中間回路と、

第1面および第2面を有する少なくとも1つの非重合層と、を含み、前記層の前記第1面が前記集積回路に構造的に結合され、前記層の前記第2面が前記中間回路に構造的に結合される、パッケージ。

2. 集積回路用のパッケージを形成する方法であつて、

電気的接続部のアレイを含む中間回路を準備するステップと、

第1面および第2面を有し、前記第1面が前記集積回路に構造的に結合するようとした少なくとも1つの非重合層を準備するステップと、

前記非重合層の前記第2面を前記中間回路に構造的に結合するステップと、を含む方法。

3. 電子パッケージであつて、

パターン化された導電層および少なくとも1つのパターン化された誘電体層を含むフレキシブルテープと、

第1面および第2面を有し、前記第1面が前記フレキシブルテープの前記導電層の前記第2面に構造的に結合されている非重合支持構造体と、を含む電子パッケージ。